



H2520 双组分银胶

H2520 是一款双组分环氧中低温银胶，专为电子部件中金属、陶瓷、塑料的粘接而设计，这些应用要求材料具备良好的粘接力，同时具有导电性和导热性。典型应用包括替代焊接、互连件的维修 / 返工，以及在焊接温度不可太高的情况下，粘接热敏元件。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观 A 组分	银白色膏体
外观 B 组分	黄色透明液体
外观 混合物	银白色膏体
组分	双组分
固化方式	室温固化和加热固化
应用	导电、粘接
典型的产品应用	替代焊接、互连件的维修 / 返工

产品优点

- 导电性良好
- 双组分，储存方便
- 耐候性优异
- 适用于高精度点胶

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
A 组分粘度 cps	38000±1000	GB/T2794,DVNXHBCP,CPA-51@5S,25℃
B 组分粘度 cps	90±5	GB/T2794,DVNXHBCP,CPA-51@300S,25℃
混合后粘度 cps	25000±1000	GB/T2794,DVNXHBCP,CPA-51@5S,25℃
混合后触变指数	4.5±0.5	GB/T 2794
比重 g/cm ³	3.6±0.1	GB/T 13354



工作时间	min	90	@ 25° C, 100% 粘度上升
最大细度	um	6-7	QXD 型刮板细度计

固化后性能

在推荐的条件下固化：

条目	典型值	备注
剪切强度 MPa	7±0.5	GB/T 7124 Al/Al, 腐蚀或摩擦
体积电阻率	$< 5 \times 10^{-4}$	四线法, 65°C/2H
剪切强度可靠性实验 MPa	> 6.5	65°C/90%RH/720H, Al/Al

典型的固化性能

固化条件

条目	典型值
热固化	120 分钟 @65°C
	60 分钟 @125°C

以上固化条件仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用说明

在 A,B 组分混合后需马上使用。A:B 混合质量比为 100:5.2。

本品在 25°C，相对湿度 < 60%的条件下，使用期是 90 min。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

- 根据客户要求



产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

如果产品以 A、B 组分分开装在不同容器中供应，需在室温下储存。如果是预混合并冷冻供应的产品，则应储存在 -40°C 的环境中。保质期会因特殊包装而有所不同。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com